



SFA 반도체

2019년 상반기 실적발표

2019.08.13



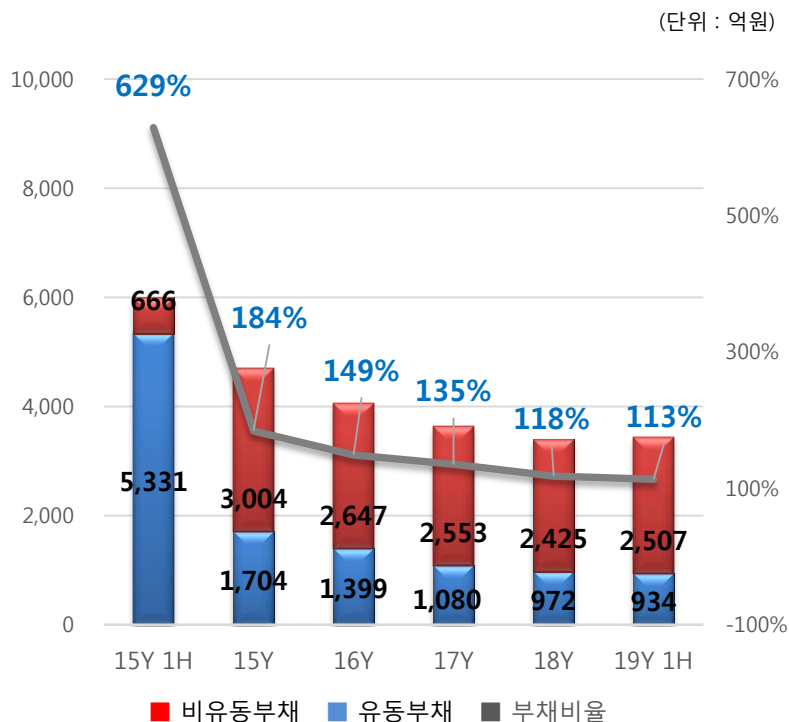
- 고부가 범핑사업 및 필리핀법인 확대로 매출 큰폭 증가 ('18년 상반기 比 매출액 약 30% 증가)
- 지속적인 경영효율화를 통하여 수익성을 확보
 - 영업이익율은 '15년 1.5%에서 '19년 상반기 5.1% 수준으로 상승
 - : SFA 경영권지분 인수 이후 지속적인 순이익 창출

연결 기준 (단위 : 억원)	15년	16년	17년	18년			19년		
				상반기	하반기	누적	1분기	2분기	상반기
매 출 액	5,165	4,292	4,496	2,073	2,506	4,579	1,170	1,479	2,649
매출 이익	396	298	389	183	284	467	84	117	201
(%)	7.7%	6.9%	8.6%	8.8%	11.3%	10.2%	7.2%	7.9%	7.6%
영업 이익	78	148	255	119	217	336	51	84	135
(%)	1.5%	3.4%	5.7%	5.8%	8.7%	7.4%	4.4%	5.7%	5.1%
순 이 익	(1,542)	76	99	79	54	133	40	53	94
(%)	(29.9%)	1.8%	2.2%	3.8%	2.1%	2.9%	3.4%	3.6%	3.5%

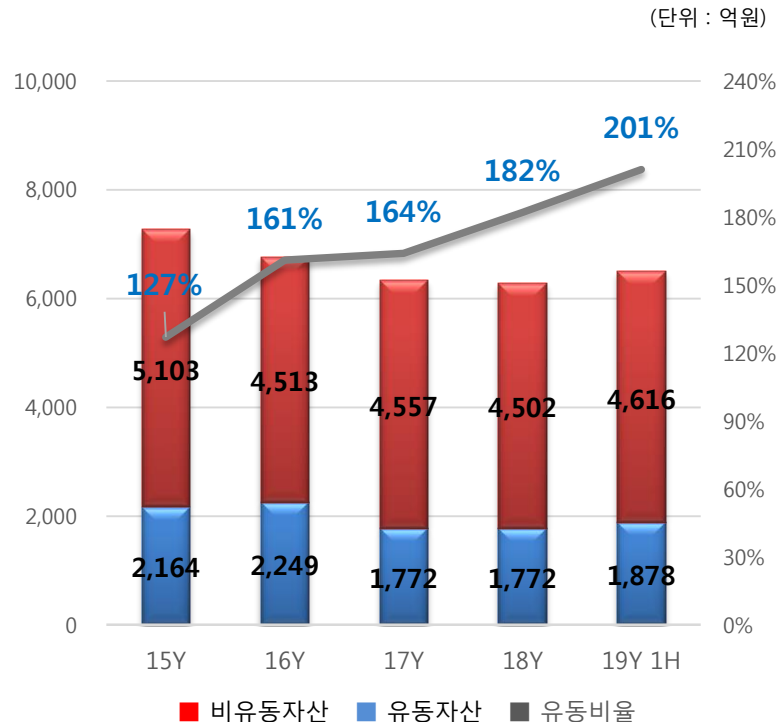
■ 재무 안정성 지속 강화

- 지속적인 수익창출과 부채 상환을 통해 부채비율 '15년 말 184% → '19년 상반기말 113%로 개선
- '15년도 부터 유동비율 매년 상승하여 현금흐름 안정성 확보

● 부채 비율



● 유동 비율





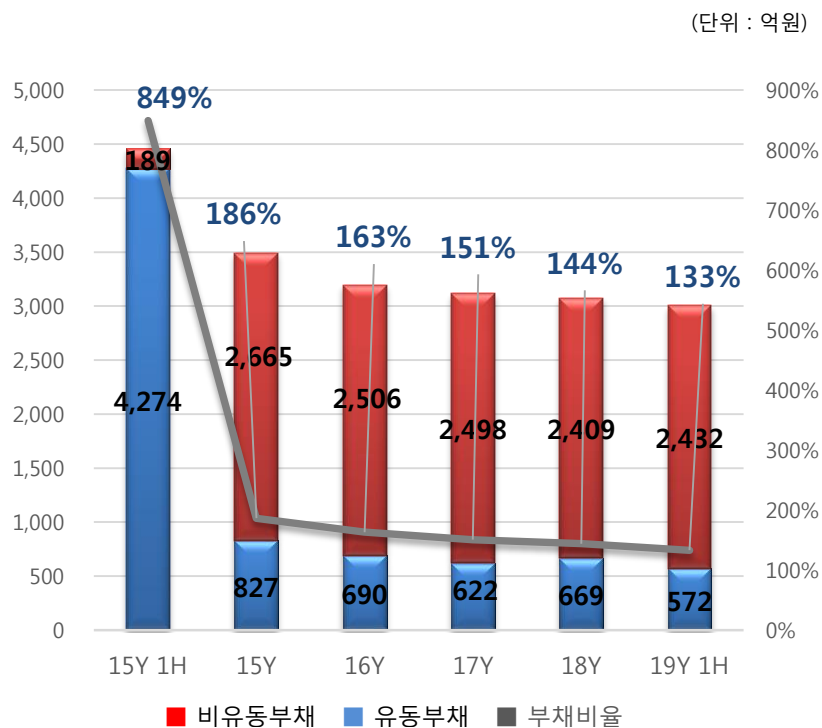
- 신규제품 도입 및 라인운용 효율화를 통한 지속적인 수익성 개선
- Bump 사업 흑자전환 달성에 따른 이익 증가

별도 기준 (단위 : 억원)	15년	16년	17년	18년			19년		
				상반기	하반기	누적	1분기	2분기	상반기
매 출 액	3,269	2,697	2,930	1,385	1,577	2,962	699	823	1,522
매출 이익	133	81	272	137	196	333	77	93	170
(%)	4.1%	3.0%	9.3%	9.9%	12.4%	11.2%	11.0%	11.4%	11.2%
영업 이익	-96	5	195	102	158	260	58	75	133
(%)	-2.9%	0.2%	6.7%	7.4%	10.0%	8.8%	8.3%	9.1%	8.8%
순 이 익	-2,178	34	67	92	-24	68	42	55	97
(%)	-66.6%	1.3%	2.3%	6.6%	-1.5%	2.3%	6.0%	6.7%	6.4%

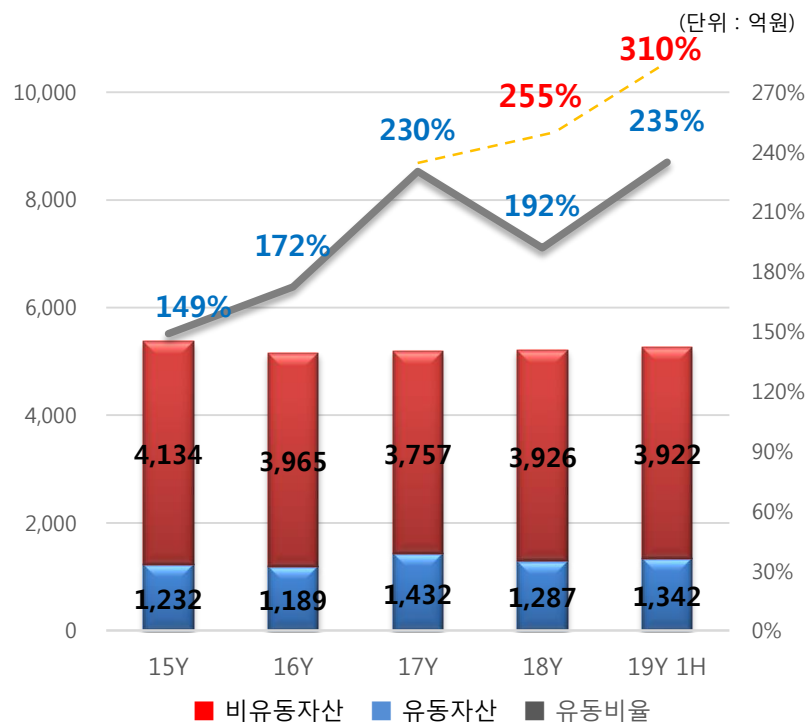
경영 실적_별도 기준 재무안정성

- 수익창출을 통해 부채비율 지속 축소
- '18년 해외법인 대여금 지급으로 유동비율 일시적 감소 (대여금 회수 시 유동비율 310%)

● 부채 비율



● 유동 비율



주요 대외 이슈



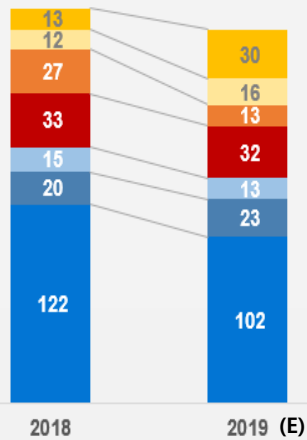
구분	긍정적인 영향	부정적인 영향
미-중 통상이슈	- 반도체 후공정의 중국 외 생산거점 필요성 확대 - 고객사의 중국 내 생산물량 SSP(필리핀) 이전 생산 중	- 중국 End User향 물량감소 가능성 - H사 제재로 신제품 개발 및 양산 계획 일부 보류
한-일 통상이슈	- 당사는 규제 품목에 해당사항 없음 - 일본 수입 원부자재(총76개) 중 전략 물자 품목은 없음	- 규제품목 확대 시 당사 매입품목 포함 가능성 - 향후 규제 대상 확대 시를 대비하여 대응 방안 사전 검토 (전략물자 비대상품목 중 7개 품목에 대한 대안 마련 중) - 우회수입, 일본 이외 공급처 확보 등을 통해 리스크 최소화 예정 - 통상이슈로 인해 고객사 생산량 감소 시 외주 물량 감소 가능성
삼성 비메모리 육성	- 범핑 등 비메모리 시장 확대 - 생산량 증가로 범핑 사업 성장 기대 - 비메모리 생산량 증가로 기존 메모리 제품 외주화 확대 가능성	해당사항 없음



SFA Manufacturing Scope (Revenue - \$ in Millions)

Die Stacking

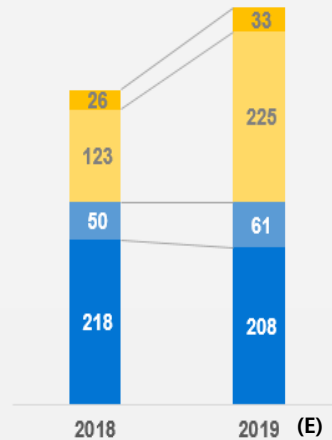
1 2 3~4 5 6~7 8 9~17



※ 당사 영업전망 기준

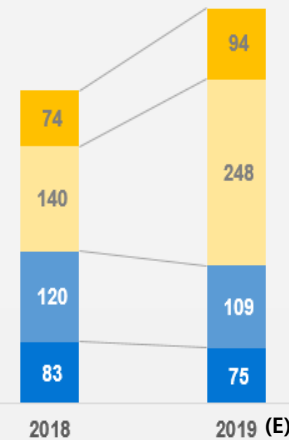
Operation

Assy Test Module Bump



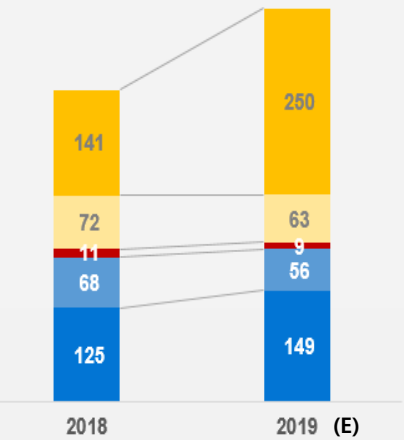
Memory vs Non-Memory

DRAM NAND+NOR
MODULE Non Memory



Market Segment

Mobile PC Automotive
Consumer Server



제품사양 변화

- 5G, Server용 저장매체 등 수요 증가로 고단 제품 증가
- 고수익 제품 증가로 매출 증가 기대

제품군 변화

- SiP(System in Package) 수요 증가에 따른 모듈 물량 증가(고용량화)
- S-LSI 사업 비중 증가에 따른 BUMP 물량 증가
- Bump 및 SSP 매출 증가 기대

비메모리 비중 확대

- 제품 다변화를 통한 지속적인 수익성 확보
- Bump 매출 비중 증가, QFN 등 신규 제품 런칭

시장규모

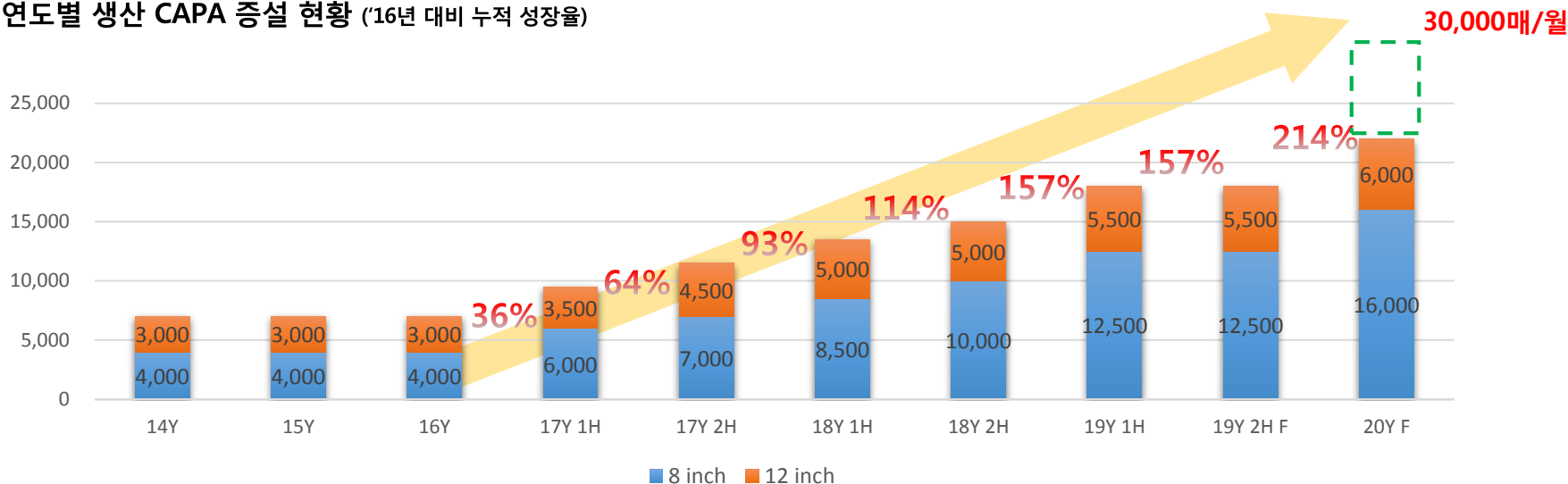
- 고성능 & 고용량화로 Server 와 Mobile 물량 증가
- 매출 증가 기대

SSK 범핑사업 확대



- 16Y 이후 성공적인 사업화 진행 중, 지속적인 CAPA 확대 지속
- Capacity & Line 확장 진행을 통한 기존고객 수요 및 신규 고객 확보 추진
- 규모의 경제 실현으로 2019년부터 plus 영업이익 확보 예상

● 연도별 생산 CAPA 증설 현황 ('16년 대비 누적 성장률)



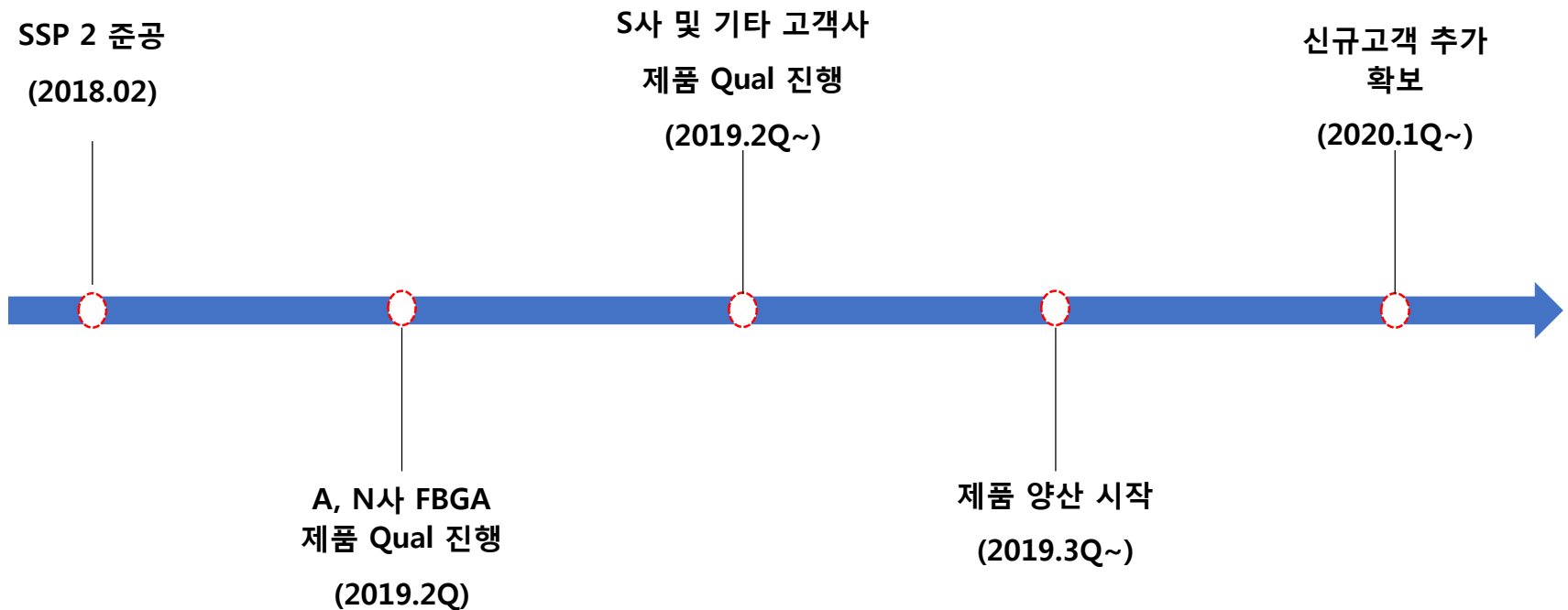
구분 (단위:억원)	14Y	15Y	16Y	17Y 1H	17Y 2H	18Y 1H	18Y 2H	19Y 1H	19Y 2H (Forecast)	20Y (Forecast)
CAPA(매)	7,000	7,000	7,000	9,500	11,500	13,500	15,000	18,000	18,000	22,000
투자금액	901	358	116	88	33	115	125	223	150	250
매출액	-	23	147	147	140	189	188	263	320	840

※ 19Y 2H와 20Y Forecast는 Full Capa 운영 할 경우의 최대 매출액

SSP 2공장_사업화 현황



- 반도체 후공정 특성 상 신규고객의 유치에는 site qual, 제품 qual 등을 위해 상당한 시간 소요
- '18년 2월 준공 이후 지속적으로 국.내외 고객사 Qual 진행하여 양산 기반 구축
- '19년 하반기부터 본격적으로 양산 진행 예정





- 先 국내/해외 Fabless 유치로 양산 경험 확보 추진 중
- 다수의 고객사 수주(신규고객 추가 확보 등)를 통해 매출 확보 예정

● SSP2 공장 영업 추진 현황

		'19.1H			'19.2H			20년 이후		
거래선	제품	Qual	시양산	양산	Qual	시양산	양산	Qual	시양산	양산
S사(韓)	eMCP(7단)				→					
	eMCP(9단)				→					
I사(韓)	QFN	→				→				
M사(韓)	LGA	→				→				
I사(美)	QFN							→		
A사(日)	FBGA	→				→				
R사(韓)	CARD	→				→				
H사(臺)	CARD				→					→
N사(韓)	FBGA	→							→	